

## 科技部 函

地址：台北市和平東路二段106號

聯絡人：潘敏治 副研究員

聯絡電話：02-2737-7983

傳真：02-2737-7673

電子郵件：mcpa@most.gov.tw

受文者：銘傳大學

發文日期：中華民國106年11月10日

發文字號：科部工字第1061005863號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：修正107年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」公告內容，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本部106年9月7日科部工字第1060070326號函諒達，本次修正重點摘錄如下：
  - (一)增列主軸六「新興半導體製程、材料與元件技術」，同時主軸一名稱原為「關鍵元件、製程與材料、感測器」修正為「前瞻感測元件、電路與系統」。
  - (二)申請人之任職機構原應於106年11月20日(星期一)前備函送達本部，延至106年12月29日(星期五)前送達。
  - (三)本專案為整合型計畫，每一整合型計畫需含總計畫與(三個(含)以上，最多以不超過六個為原則)之子計畫。
  - (四)原計畫名稱「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」修正為「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫(半導體射月計畫)」。
  - (五)計畫具體目標導向：總計畫內容須明確陳述整體總目標，應具有開創新思維且以挑戰數量等級的規格改善為宗旨。

(六)申請團隊於提出總計畫書時，必須包含【業界合作意願書】，請將此意願書附於計畫書表CM03 研究計畫內容之後，並於計畫內容簡述申請團隊與業界預計之合作方式。

(七)本計畫規劃四年期間修正自107年5月1日至111年4月30日，業經審查通過，核定補助二年期間修正自107年5月1日至109年4月30日。

二、本計畫修正細節，請詳閱公告相關內容紅色字體所示。

三、本計畫徵求公告相關內容業已公佈於本部網站與本部工程司網站(<https://www.most.gov.tw/eng/ch>)-公告事項。

正本：專題研究計畫受補助單位（共303單位）

副本：本部綜合規劃司、工程司

部長陳良基

【簽辦紀錄 - NO.176322】

秘書處-外文處理者, 藍淑貞 (2017-11-13 10:29, 附件異動)

秘書處-登記桌, 賴數淑 (2017-11-13 14:56, 分文)

研究發展處-登記桌, 高維翎 (2017-11-13 15:56, 分文)

研究發展處-研究暨評量組-一般職員, 李心怡 (2017-11-13 16:54, 陳核): 一、科技部來函修正107年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」公告內容。

二、本計畫請於106年12月22日(星期五)中午12時前於線上提出申請，並致電研發處(分機2651)確認，以利彙整辦理。三、擬呈核後公告。

研究發展處-研究暨評量組-組長, 李孟真 (待處理)